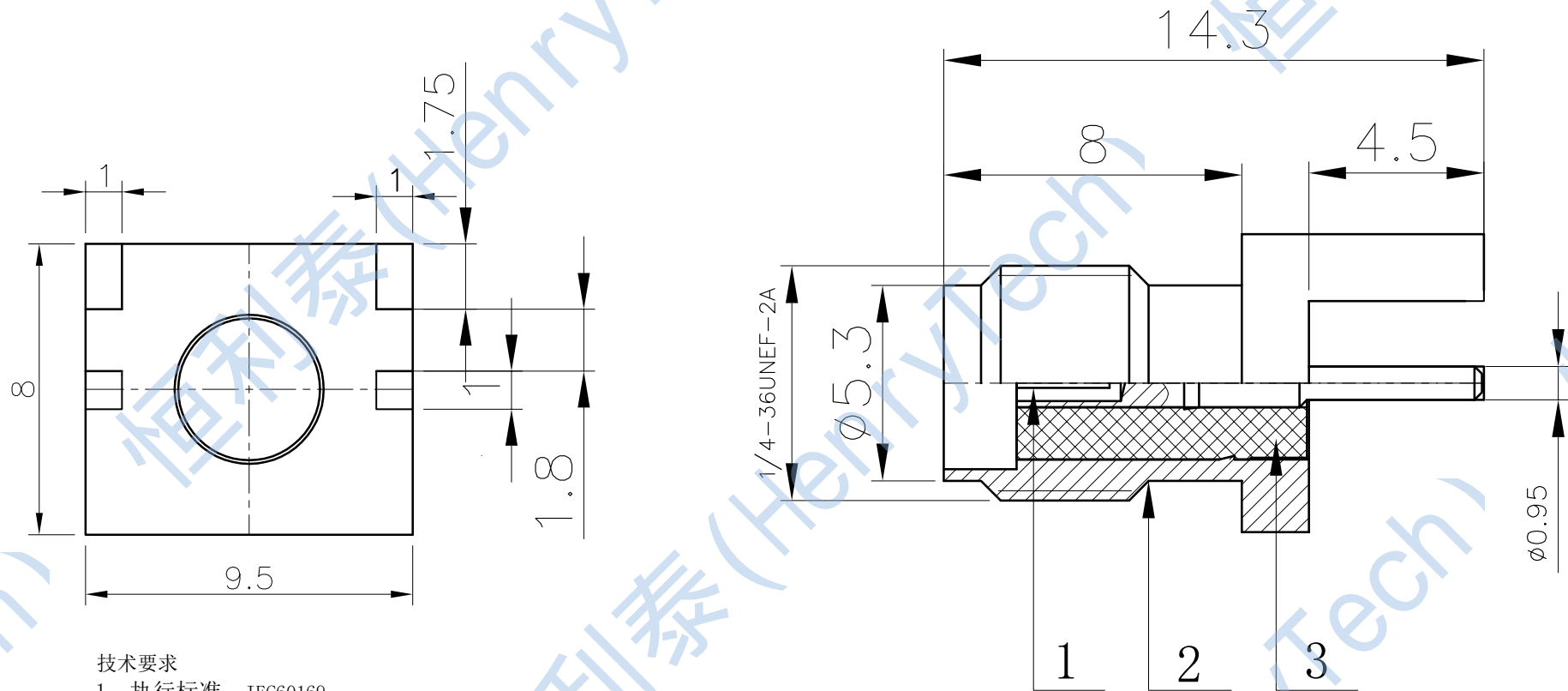


|    |      |      |    |    |   |    |      |         |    |    |    |
|----|------|------|----|----|---|----|------|---------|----|----|----|
| 1  | 2    | 3    | 4  | 5  | 6 | 7  | 8    |         |    |    |    |
| 修订 | 变更描述 | 变更单号 | 签名 | 日期 |   | 3  | 绝缘体  | PTFE    |    | 1  |    |
|    |      |      |    |    |   | 2  | 外壳   | HPb59-1 | 金  | 1  |    |
|    |      |      |    |    |   | 1  | 插孔   | HPb59-1 | 金  | 1  |    |
|    |      |      |    |    |   | 序号 | 零件名称 | 材质      | 涂覆 | 数量 | 备注 |



技术要求

- 1、执行标准: IEC60169
- 2、特性阻抗: 50 Ω
- 3、频率范围: 0 ~6GHz
- 4、绝缘电阻: ≥5000MΩ
- 5、介质耐压: 1000V (AC 有效值)
- 6、内导体分离力: ≥0.28 N
- 7、轴向保持力: ≥ 22 N
- 8、连接机构耐力距: ≥1.7 N·m
- 9、机械寿命: ≥ 500 次
- 10、温度范围: -55℃~165℃
- 11、接触电阻: 外导体间<2mΩ, 内导体间<3mΩ

|    |  |                  |               |    |    |  |               |
|----|--|------------------|---------------|----|----|--|---------------|
| 制图 |  | 版次               |               | 比例 |    | 型号规格   | HL2-SMA-KEP-8 |
| 审核 |  | 投影               |               |    |    |  | 品名            |
| 批准 |  | 未标注公差的, 以下列公差表为准 |               |    |    | 成都恒利泰科技有限公司<br>Chengdu HenryTech Technology co., Ltd |               |
|    |  | 1. X, X±0.2      | 4. 去除锐边最大0.1  |    |    |  |               |
|    |  | 2. X, XX±0.1     | 5. 表面粗糙度Ra3.2 |    |    |  |               |
|    |  | 3. 角度±1°         | 6. 倒角CO.15MAX |    |    |  |               |
|    |  | * 为重点尺寸          |               | 单位 | mm |  |               |